

金元证券股份有限公司

关于广东世运电路科技股份有限公司使用募集资金

对子公司增资之保荐机构核查意见

金元证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就世运电路使用募集资金向子公司鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称“世安电子”）增资事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕351号文批准，广东世运电路科技股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股 8,880 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 15.08 元/股，募集资金总额 133,910.4 万元，扣除发行费用 8,161.224 万元后，募集资金净额 125,749.176 万元，募集资金已于 2017 年 4 月 20 日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行（账号：2012006229248000189）、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行（账号：735468609166）、中国建设银行股份有限公司（账号：44050167070100000233）。2017 年 4 月 20 日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34 号）。

二、募集资金投资项目和本次增资基本情况

根据公司《首次公开发行股票发行方案》，本次公开发行所募集资金扣除发行费用后将投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额	项目备案号
----	------	------	----------	-------

1	年产 200 万平米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目	108,000.00	108,000.00	2016-440784-39-03-008623
2	补充 3 亿元流动资金项目	30,000.00	17,756.26	-
合计		138,000.00	125,756.26	-

募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决。

鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称“世安电子”）为公司首次公开发行股份募集资金投资项目中“年产 200 万平米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”的实施主体，负责实施的募投项目投资总额为 108,000.00 万元，拟使用募集资金 108,000.00 万元。

公司直接及间接合计持有世安电子 100% 股权，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已以往来款形式拨付世安电子合计 63,422.81 万元募集资金用于年产 200 万平米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目的前期投入。

为保证世安电子负责实施的年产 200 万平米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目的顺利实施，根据公司 2019 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司对子公司世安电子增资的议案》，公司将使用首次公开发行募集资金 70,000.00 万元向世安电子进行增资，其中包括公司已以往来款形式拨付科技公司用于项目前期投入的 63,422.81 万元。

本次拟以人民币 70,000 万元对世安电子进行增资，其中人民币 8,000 万元计入注册资本，62,000 万元计入资本公积。增资完成后世安电子注册资本将由人民币 22,000 万元增至人民币 30,000 万元，控股股东与实际控制人未发生变更。

三、本次增资对象的基本情况

公司名称：鹤山市世安电子科技有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

统一社会信用代码：914407840506946888

住所：鹤山市共和镇铁岗居委会

法定代表人：余英杰

注册资本：22,000 万元人民币

成立日期：2012 年 07 月 24 日

营业期限：长期

经营范围：生产经营线路板（含高密度互连积层板、柔性线路板）及混合集成电路。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次增资拟用货币出资，资金来源为世运电路的募集资金，增资前后世安电子的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
世运电路	1,800	8%	9,800	32.67%
世运电路科技	20,200	92%	20,200	67.33%
合计	22,000	100%	30,000	100%

注：世运电路科技为公司全资子公司。

公司拟以本次募集资金人民币 70,000 万元对世安电子进行增资，其中增加注册资本人民币 8,000 万元，其余部分计入资本公积；增资完成后，世安电子注册资本变更为人民币 30,000 万元，公司直接及间接合计持有世安电子 100% 的股权。

四、本次增资的目的和对上市公司的影响

（一）公司本次向子公司世安电子增资的资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金，该等资金将全部用于世安电子负责实施的“年产 200 万平米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”的实施，符合公司的战略发展方向和经营发展规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（二）本次增资完成后，世安电子实际控制人未发生变更，没有新增关联交易、同业竞争，公司合并报表范围没有发生变更。

五、本次增资的审议程序和专项意见

2016 年 9 月 12 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了本次募集资金的使用方案。其中，募集资金的实施主体为公司及子公司世安电子。

2019年4月9日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金对子公司鹤山市世安电子科技有限公司增资的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司使用募集资金对子公司世安电子进行增资，并发出了股东大会通知，拟于公司2018年年度股东大会进行审议表决。

六、核查结论

保荐机构核查意见本保荐机构经核查后认为：经审慎核查，世运电路本次使用募集资金对子公司世安电子增资，符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，且履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。

基于以上意见，保荐机构对世运电路本次使用募集资金对子公司世安电子增资事项无异议。

【本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司使用募集资金对子公司增资之保荐机构核查意见》之签字页】

保荐代表人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '崔健民', written over a horizontal line.

崔健民

【本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司
使用募集资金对子公司增资之保荐机构核查意见》之签字页】

保荐代表人：  _____

肖晴箏

【本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司使用募集资金对子公司增资之保荐机构核查意见》之盖章页】

